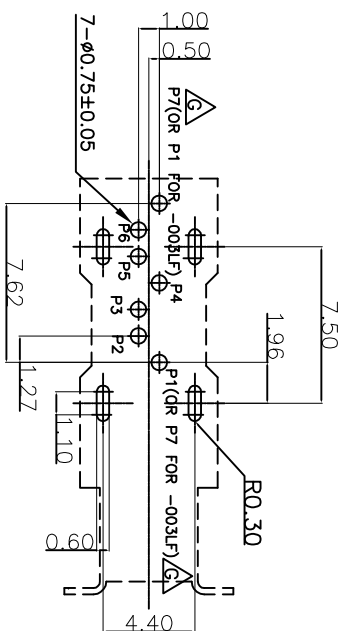
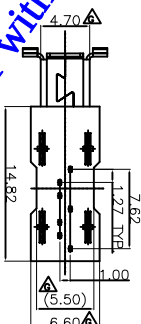
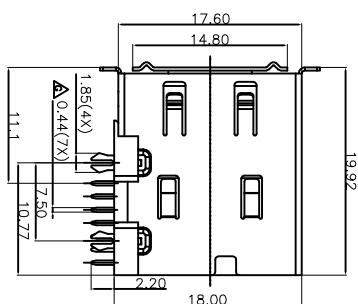
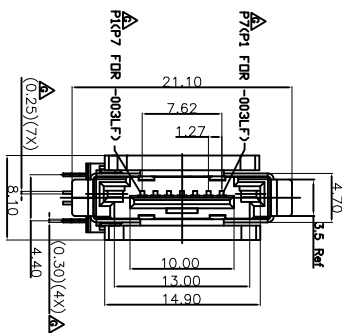


PRODUCT NO.
10074141-001LF
10074141-003LF



PIN DEFINITION

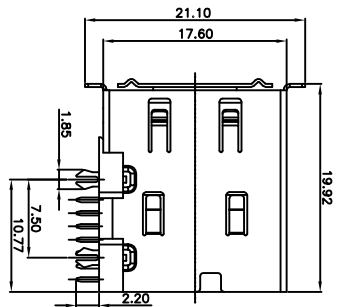
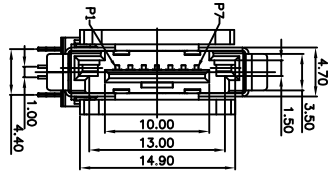
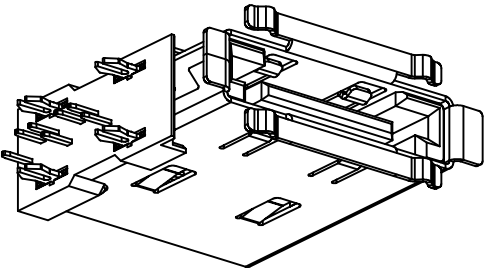
ESATA	NAME	TYPE
P1	GND	
P2	A+	
P3	A-	
P4	GND	
P5	B-	
P6	B+	
P7	GND	

RECOMMEND P.C. BOARD LAYOUT PCB TOLERANCE:±0.05

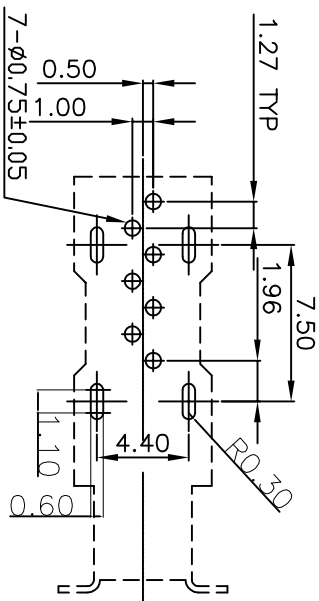
mat'l. code				surface 58		tolerance		projection		product family	
14				ISO 1302		ISO 406 150		101		533	
lfr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title	
A	107-1074S	LIN	2007-05-23	angles		.X±0.38		MM		E-SATA_UP_RIGHT	
B	108-1082S	LIN	2008-04-28	linear		.XX±0.25		MM		DIP_TYPE	
C	110-0184S	LIN	2010-12-14	0°±2°		.XXX±0.100		scale 2:1			
D	1-00544QS	LIN	2011-08-31	dr		STERLING.LIN		2007-05-21		dwg no	
E	EX-S-00781	HKL	2011-10-17	eng		HKLIM		2016-03-03			
F	EX-S-01187	HKL	2012-06-08	chr		HKLIM		2016-03-03			
G	EX-S-2340	HKL	2016-03-03	ppd		KPTAY		2016-03-03			
sheet	revision	G	G	107	109	111	113	115	117	119	121
index	sheet	1	2	3	106	108	110	112	114	116	118

NOTES:
1. MATERIAL: HOUSING-THERMAL/PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
CONTACT-SOLDER ALLOY
SHELL/BOARD LOCK COPPER ALLOY
2. FINISH: 500" MIN. MATT TIN PLATING ON SOLDER TAILS
SHELL/BOARD LOCK:50" MIN. NICKEL PLATING OVER ALL
3. THE HOUSING WILL WITHSTAND TO 260C FOR 10 SEC
IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6MM PCB
4. PRODUCT SPEC : GS-12-386
5. PACKING SPEC : GS-14-1109
6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools



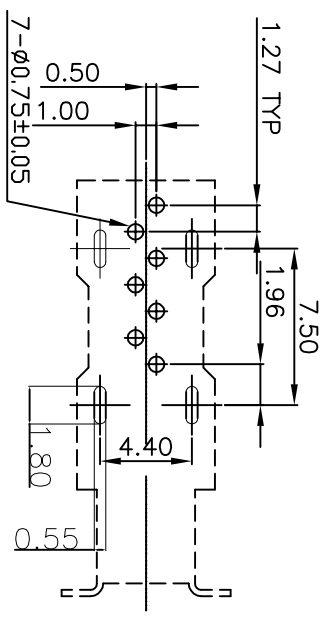
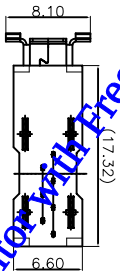
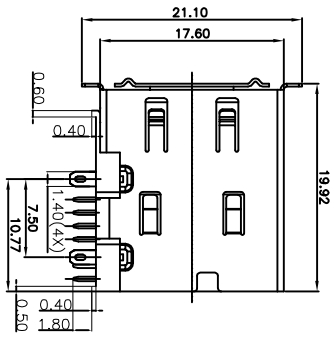
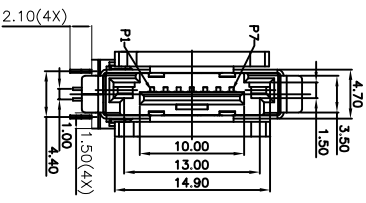
ESATA	
NAME	TYPE
P1	GND
P2	A+
P3	A-
P4	GND
P5	B-
P6	B+
P7	GND



P.C.BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm

PCB TOLERANCE: ± 0.05 [illegible]

NOTES:
1. MATERIAL: THERMAL PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
FOSSING COLORBLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
SHELL/BOARD LOCK: COPPER ALLOY
2. FINISH:
CONTACT GOLD PLATING ON CONTACT AREA
500" MIN. WALT IN PLATING ON SOLDERTAILS
BOARD LOCK: 50" MIN NICKEL PLATING OVER ALL
80" MIN WALT IN PLATING OVER ALL
SHELL/BOARD LOCK: 50" MIN NICKEL PLATING OVER ALL
3. THE HOUSING MUST BE WELDED TO THE BOARD FOR 10 SECS
IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6MM PAD
4. PRODUCT SPEC : GS-12-386
5. PRODUCT NUMBERING:
10074141 - 0 A U¹ - LEAD FREE
PICKING:
BLANK TRAY PICKING
1: 15u" GOLD PLATING
2: G/F GOLD PLATING
1: LAYOUT?
6. A SYMBOL  WILL BE USED TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION



P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm

PCB TOLERANCE: ±0.05

PIN DEFINITION	
NAME	TYPE
P1	GND
P2	A+
P3	A-
P4	GND
P5	B-
P6	B+
P7	GND

- NOTES:
1. MATERIAL: THERMOPLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
 2. FINISH: CONTRACT GOLD PLATING ON CONTACT AREA
 3. THE HOUSING WILL WITHSTAND TO 260C FOR 10 SEC IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5MM PCB
 4. PRODUCT SPEC : 05-12-386
 5. PACKING SPEC : 05-14-1109
 6. A SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

mat'l. code		surface sg		tolerance		projection		product family	
lfr	ecn no	dr	date	ISO 1302	ISO 406	ISO 101	MM	533	
A	107-1074S	UN	2007-05-23	tolerances unless otherwise specified	.XX±0.38			E-SATA_UP_RIGHT	
B	108-1082S	UN	2008-04-28		.XX±0.25			DIP_TYPE	
C	110-0184S	UN	2010-12-14	0°±2°	.XXX±0.100	scale 2:1			
D	1-00544QS	UN	2011-08-31	STERLING	2007-05-21				
E	EX-S-007881	HKL	2011-10-17	ENG	HKLIM	2016-03-03			
F	EX-S-011878	HKL	2012-06-08	CH	HKLIM	2016-03-03			
G	EX-S-23409	HKL	2016-03-03	QPP	KPTAY	2016-03-03			
Sheet	revision	1	2	3	107 109	111 113 115	117 119	121 123 125 127 129	131 133 135 137 139
index	sheet	G	G	G	106 108	110 112 114	116 118	120 122 124 126	128 130 132 134 136 138

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9